

成都高新区电子信息产业局

成高电发〔2022〕1号

签发人：杨 刚

成都高新区电子信息产业局 关于印发《〈成都高新技术产业开发区关于支持 集成电路设计产业发展的若干政策（修订）〉 实施细则》的通知

各有关单位：

根据《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》（成高管发〔2022〕4号）相关内容，现将制定的《〈成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）〉实施细则》印发你们，请遵照执行。

附件：成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）实施细则

成都高新区电子信息产业局

2022年9月14日



附件

《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》实施细则

为贯彻落实《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路产业发展的若干政策（修订）》（成高管发〔2022〕4号），进一步细化政策内容，理顺操作规程，确保政策实施依法合规并取得实效，特制定本实施细则。

一、支持范围

支持对象为从事集成电路设计，且工商、税收和统计关系在成都高新区，具有独立法人资格的企业。

二、申报规程

（一）设计环节

支持方向一：鼓励企业购买 IP（知识产权）、EDA 设计工具。对向 IP 提供商购买 IP（含 Foundry IP 模块）、向 EDA 供应商购买 EDA 设计工具进行研发的集成电路设计企业，给予购买费用 50%、年度总额最高 500 万元的补贴。

1、申报主体

成立一年以上，具有独立法人资格，工商、税收和统计关系在成都高新区，从事集成电路（含 IP）研发、销售的企业。

2、申报条件

上一年度，直接购买 IP 提供商提供的 IP(不包括委外研发)、EDA 供应商提供的 EDA 设计软件用于芯片研发或者使用本地 EDA 云平台进行芯片研发，并流片验证的企业（卖方应为原始 IP、EDA 提供商、晶圆代工厂或原始提供商、晶圆代工厂指定的代理）。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路政策资金申报书》应按以下顺序装订成册。

(1) 《成都高新区集成电路政策资金申报表》。

(2) 申报单位提供统一社会信用代码营业执照（法人登记证）复印件和法定代表人身份证复印件。

(3) 企业提供 IP 和 EDA 的采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件等；

(4) 流片项目的工程流片加工业务统计表，工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）。通过第三方服务平台或代理机构委托流片，企业还需提供 WIP 信息、IP merge 信息和出货清单（加盖申报企业和服务平台或代理机构鲜章）。如果不能提供 WIP 信息、IP merge 信息，需提供出货清单和芯片实物照片。

(5) 芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件。

(6) 采用 EDA 开展研发产品情况简介及产品供销合同（加盖供需双方鲜章）；如果采购 IP，提供采购的 IP 功能（模块）

介绍及使用购买 IP 研发的芯片介绍（需详细说明购买 IP 在新研芯片中的功能、作用等信息，加盖申报单位鲜章），有销售提供芯片销售合同。

（7）企业近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

（8）经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）。

（9）税务局出具的企业近三年的缴税证明（加盖申报企业鲜章）。

（10）其它选择提交的补充支撑材料（含采购产品的知识产权证书、参与国家/省/市级项目情况、近两年财务情况、品牌知名度证明文件、单位资质、发明专利情况、单位信用证明、产品购销合同等）。

（11）申报单位提供供需双方无关联关系承诺书、申报材料真实性及不重复申报承诺书（加盖申报单位鲜章）。

4、支持标准

经认定，按企业购买 IP、EDA 工具费用给予 50%、单个企业年度总额最高 500 万元的补贴。

5、申报说明

上述材料需要真实有效，复印件需要加盖企业鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

(二) 制造环节

支持方向二：对于首次申报 MPW（多项目晶圆）的项目，认定为先进领域后，给予流片费用 80% 的补贴，最高 300 万元。

支持方向三：对于首次申报工程批流片的项目，认定为先进领域后，给予流片费用 50% 的补贴，最高 500 万元。

支持方向四：对于首次申报批量生产的项目，且产品销售收入超过 500 万元的，按其光罩费用的 30% 给予补贴，最高 200 万元。

在具备条件的情况下，若企业实现本地流片，则上述支持方向的补贴比例和额度可进一步上浮。

1、申报主体

成立一年以上，具有独立法人资格，工商、税收和统计关系在成都高新区，从事集成电路（含 IP）研发、销售的企业。

2、申报条件

上一年度实施并首次申报的 MPW（多项目晶圆）、工程批或批量生产流片项目。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路政策资金申报书》应按以下顺序装订成册，申报支持方向四的提供《成都高新区集成电路专项政策资金申报书》。

(1) 《成都高新区集成电路政策资金申报表》，申报支持方向四的提供《批量生产流片光罩补贴资金申报表》。

(2) 企业法人提供统一社会信用代码营业执照复印件和法定代表人身份证复印件。

(3) 流片项目的工程流片加工业务统计表，工程流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）。通过第三方服务平台或代理机构委托流片，企业还需提供WIP信息和出货清单（加盖申报企业和服务平台或代理机构鲜章）。

(4) 流片的芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件。

(5) ①MPW或工程批流片产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明、市场销售证明材料等）（加盖申报企业鲜章）。

②批量生产流片（晶圆25片以上）需提供批量生产流片合同、光罩购买合同、发票，以及相应芯片的销售证明材料：与购买方签订的合同、收款凭证、公司开具的发票。合同产品型号、芯片版图需与光罩一致（加盖申报企业鲜章），如果不一致，需提供详细的证明材料。

(6) 反映企业自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权、企业技术中心等）复印件。

(7) 企业近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

(8) 其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、

品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等)。

(9) 经审计的上年度会计报表或审计报告(带二维码)。

(10) 税务局出具的企业近三年的缴税证明(加盖申报企业鲜章)。

(11) 申报单位提供供需双方无关联关系承诺书、申报材料真实性及不重复申报承诺书(加盖申报单位鲜章)。

4、支持标准

支持方向二：对于首次申报的使用 MPW(多项目晶圆)流片的项目，按照流片直接费用的 80%给予补贴，单个企业最高 300 万元。

支持方向三：给予完成全掩膜(FullMask)工程产品流片(晶圆不超过 25 片)并首次申报的项目，按流片费用的 50%给予补贴，单个企业最高 500 万元。

支持方向四：对于首次申报批量生产(流片晶圆 25 片以上)的项目，且产品销售收入超过 500 万元的，按其光罩费用的 30%给予补贴，单个企业最高 200 万元。

5、申报说明

上述材料需要真实有效，复印件需要加盖企业鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

（三）封测环节

支持方向五：鼓励企业利用封装测试企业进行首轮封装测试，认定后，对在区内封测企业进行封装测试的，按照封测费用的10%给予最高200万元的补贴；对在区外封测企业进行封装测试的，按照封测费用的5%给予最高100万元的补贴。

1、申报主体

成立一年以上，具有独立法人资格，工商、税收和统计关系在成都高新区，从事集成电路（含IP）研发、销售的企业。

2、申报条件

上一年度，进行研发芯片首次封装测试的项目。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路政策资金申报书》应按以下顺序装订成册。

（1）《首轮封装测试补助资金申报表》。

（2）企业法人提供申报企业的统一社会信用代码营业执照（法人登记证）复印件和法定代表人身份证复印件。

（3）企业提供首次封测业务统计表，与集成电路封测企业签订的封装合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业鲜章）。通过第三方服务平台或代理委托封装，需提供

委托封装统计表、与服务平台或代理之间的封装合同、发票、银行划款凭证及服务平台或代理与集成电路封测企业之间的封装合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件（加盖申报企业和服务平台鲜章）。

（4）芯片版图缩略图、封装图纸及封装后实物图片。合同中型号与芯片、实物图片中标识一致，如不一致，需说明原因。

（5）封装芯片产品的情况说明（产品主要功能及用途、技术指标及先进性、与公司其他相关产品的差异说明、市场销售证明材料等）（加盖申报企业鲜章）。

（6）反映企业自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权、企业技术中心等）复印件。

（7）企业近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

（8）其它补充支撑材料（企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等）。

（9）经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）。

（10）税务局出具的企业近三年的缴税证明（加盖申报企业鲜章）。

（11）申报单位提供供需双方无关联关系承诺书、申报材料真实性及不重复申报承诺书（加盖申报单位鲜章）。

4、支持标准

对在区内封测企业进行首次封装测试的，按照封测费用的10%给予最高200万元的补贴；对在区外封测企业进行首次封装测试的，按照封测费用的5%给予最高100万元的补贴。封测费用包含对应芯片的封装费、测试费以及购买夹具、引线框架、基板等辅助材料费用。

5、申报说明

上述材料需要真实有效，复印件需要加盖企业鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

（四）上台阶奖励

支持方向六：对新引进项目或存量企业增资项目的集成电路设计业务收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的高增长集成电路设计企业，经认定，分别给予500万元、1000万元、2000万元、3000万元奖励，同一企业按差额补足方式最高奖励3000万元。

1、申报主体

具有独立法人资格，工商、税收和统计关系在成都高新区，经评估的集成电路设计企业。

2、申报条件

2019年1月1日起，新注册IC设计企业、已与管委会签署新项目投资合作协议或未签署投资合作协议但有实际增资的存量IC设计企业，上一年度集成电路设计业务收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路政策资金申报书》应按以下顺序装订成册。

(1) 《规模上台阶奖励资金申报表》。

(2) 申报企业的统一社会信用代码营业执照（法人登记证）复印件和法定代表人身份证复印件。

(3) 存量企业有与高新区管委会签署投资合作协议的，提供协议复印件；未签署投资合作协议的，提供到位市外资金或新增固定资产投资1000万元以上的证明材料。市外资金证明材料包括市外投资方证明材料（自然人身份证复印件或法人营业执照复印件）、验资报告复印件，若无验资报告则须提供公司章程以及标注为“投资款”（市外汇入）的银行进账单复印件。固定资产投资证明材料指同级统计部门确认的固定资产投资报表，且项目要进固投统计库。

(4) 税务局出具的企业近三年的缴税证明（加盖申报企业鲜章）。

(5) 经审计的近3年公司业务审计报告（带二维码）。

(6) 经审计的近2年集成电路设计业务营收审计报告(带二维码)。

(7) 申报企业提供批量流片信息(流片加工合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件)(加盖申报企业鲜章)

(8) 企业芯片产品的情况说明(产品主要功能及用途、技术指标及先进性等)(加盖申报企业鲜章)。

(9) 反映企业自主创新能力的证明材料(集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权、企业技术中心等)复印件。

(10) 企业近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

(11) 其它补充支撑材料(企业参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明等)。

4、支持标准

对集成电路设计业务收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的高增长集成电路设计企业,经认定,分别给予500万元、1000万元、2000万元、3000万元奖励,同一企业按差额补足方式最高奖励3000万元。

5、申报说明

上述材料需要真实有效,复印件需要加盖企业鲜章,原件在项目审核、审计时使用;相关数据需与上报统计部门数据一致。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

（五）高端人才奖励

支持方向七：对集成电路企业高级管理人才和研发人才在落户、住房保障、医疗保障、子女就学、创新创业等方面给予支持，分层级给予企业最高 50 万元/人的人才奖励。

1、申报主体

集成电路企业，含企业化运作的公共服务平台、产业基金等。

2、申报条件

（1）企业所申请奖励的人才需与所在企业签订了劳动合同，从事集成电路设计或高级管理工作。高级管理人才需是副总经理级及以上高管（一个单位不超过 3 人），研发人才需是经评估的集成电路设计企业的研发人才。

（2）企业对人才的年度人力资源成本支出达 30 万元以上。人力资源成本包括：企业支付给员工的薪酬，企业为员工缴纳的社保。

（3）申请奖励的人才没有受到刑事处罚，或刑事处罚已经结束。

（4）以上条件需同时满足。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路项目资金申报书》，应按以下顺

序装订，由企业汇总成册后提交。

(1) 企业提供统一社会信用代码营业执照复印件和法定代表人身份证复印件。

(2) 税务局出具的企业近三年缴税证明（加盖企业鲜章）

(3) 高端人才奖励资金申报表。

(4) 企业缴纳申报人的社保材料

(5) 成都市社会保险个人参保缴费证明（本人签字）。

(6) 员工年度支付综合所得收入和扣缴个人所得税情况表、年度个人所得税完税证明。

(7) 申报人才的学位学历证明、任职文件、劳动合同复印件。

(8) 补充支撑材料（参与项目、取得成果、获得荣誉）。

(9) 申报材料真实性、不重复申报、没有受到刑事处罚或刑事处罚已经结束承诺书（个人签名加盖手印，加盖企业鲜章）。

备注：如果企业申报人数较多，(1) - (4) 可以共用，按(5) - (9) 的顺序装订人才 A 的材料后，再按(5) - (9) 的顺序装订人才 B 的材料，以此类推.....

4、支持标准

经认定，对企业人力资源成本支出超过 30 万元、50 万元、80 万元、150 万元、300 万元以上的人才，分别按照 2 万元、6 万元、10 万元、25 万元、50 万元/人的标准给予企业人才奖励。

5、申报说明

上述材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位（企业）鲜章，原件在项目审核、审计时使用；相关数据需与上报统计部门数据一致。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

（六）支持本地采购

支持方向八：鼓励区内通信、模组、系统（整机）、终端企业采购区内集成电路企业产品。对于采购非关联关系企业自主研发设计生产芯片的企业，且采购金额累计在 500 万元以上，给予采购方采购金额最高 10%、年度总额最高 500 万元的补贴。

1、申报主体

具有独立法人资格，工商、税收和统计关系在成都高新区的系统（整机）、终端企业。

2、申报条件

（1）上一年度，成都高新区系统（整机）、终端、模组企业采购区内非关联 IC 设计企业自主设计的芯片产品。

（2）采购企业使用所购芯片用于具有自主知识产权的系统（整机）、终端、模组产品，并形成实物工作量（产值）。

（3）以上条件需同时满足。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路政策资金申报书》应按以下顺序装订成册。

(1) 《成都高新区集成电路政策资金申报表》。

(2) 企业法人提供统一社会信用代码营业执照复印件及法定代表人身份证复印件。

(3) 与非关联集成电路设计企业，或企业的授权代理商签订的订货合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件。如是集成电路非关联企业的授权代理商需提供其代理证或代理合作协议复印件。

(4) 集成电路企业的芯片的版图缩略图及正版软件使用证明。

(5) 反映集成电路企业产品自主创新能力的证明材料（集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）复印件。

(6) 产品情况简介，产品销售或被采购应用的相关证明材料（加盖申报企业鲜章）。

(7) 近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

(8) 其它补充支撑材料（企业、单位参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、企业资质、发明专利情况、企业信用证明、市场应用购销合同及相关凭证等相关材料复印件）。

(9) 经审计的上年度会计报表或审计报告（带二维码）。

(10) 税务局出具的企业近三年的缴税证明（加盖申报企业

鲜章)。

(11) 申报企业提供供需双方企业无关联关系承诺书、申报材料真实性及不重复申报承诺书(加盖申报企业鲜章)。

4、支持标准

经认定,系统(整机)、终端、模组企业配套使用集成电路企业自主研发设计生产的芯片,年累计订单采购额在 500 万元以上(含 500 万元),按订单金额的 10%补助系统(整机)、终端企业。单个企业一个申报年度,补助总额不超过 500 万元。

5、申报说明

上述材料需要真实有效,复印件需要加盖申报单位(企业)鲜章,原件在项目审核、审计时使用;相关数据需与上报统计部门数据一致

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

(七)支持平台建设

支持方向九:鼓励企业(单位)建设集成电路公共技术平台,对新认定的集成电路公共技术平台,按建设投资额 50%给予不超过 500 万元的一次性资金支持;按照企业使用平台服务费用的 20%,给予公共技术平台每年最高 20 万元补贴。

1、申报主体

经成都高新区科技创新局认定的集成电路公共技术平台。

2、申报条件

在 2020 年 8 月 2 日后经成都高新区科技创新局新认定（建设）的公共技术平台（平台的工商、税务和统计关系需在高新区），为成都高新区主导产业及重点支持领域企业提供技术服务，上年度服务区内企业的技术服务费用总额不低于 100 万元，新认定（建设）的公共技术平台建成时限及相关费用的发生距离新认定（建设）的时间不超过 36 个月。以及未申请《成都高新技术产业开发区关于深化产业培育实现高质量发展若干政策意见（修订）》对 2021 年企业使用平台服务费补贴的已认定集成电路公共技术平台。

3、申报材料

提交《成都高新区集成电路专项政策资金申报书》应按以下顺序装订成册。

（1）《公共技术平台补助资金申报表》。

（2）企业统一社会信用代码营业执照复印件及法定代表人身份证复印件。

（3）获得科技创新局认定的批复文件复印件（必要时检查原件）。

（4）平台建设方案（应包括建设目标、建设内容、进度安排、经费预算、培训人员名单等）（加盖企业或单位鲜章）

(5) 建设投入佐证材料及平台投资建设经费的带防伪二维码审计报告。

(6) 近两年获得财政资金支持的项目情况说明。

(7) 上一年度服务区内企业的技术服务费用的带防伪二维码审计报告以及平台与服务企业的协议和发票。如果只申报平台服务补贴，无须提供上述(4)、(5)材料。

(8) 其它补充支撑材料(平台参与国家/省/市级项目情况、品牌知名度证明文件、发明专利情况、市场应用购销合同及相关凭证等相关材料复印件)。

(9) 税务局出具的企业近三年的缴税证明(加盖申报企业鲜章)。

(10) 申报单位提交申报材料真实性及不重复申报承诺书(加盖企业或单位鲜章)。

4、支持标准

对新认定的集成电路公共技术平台，按建设投资额(仪器设备、软硬件信息系统及测试环境打造等)的50%给予不超过500万元的一次性资金支持；按照企业使用平台服务费用的20%，给予公共技术平台每年最高20万元补贴。该政策条款与《成都高新技术产业开发区关于深化产业培育实现高质量发展若干政策意见(修订)》中同类条款不重复享受。

5、申报说明

上述材料需要真实有效，复印件需要加盖申报单位(企业)

鲜章，原件在项目审核、审计时使用。

6、申报时间

以每年发布申报通知为准。

7、受理部门

成都高新区电子信息产业局

三、申报、审核程序

（一）本政策依托“高新通”企业服务平台实行网络化、无纸化申报；

（二）成都高新区电子信息产业局制定政策申报通知，在成都高新区公众信息网公告；

（三）申报单位按照通知要求准备并提交申报材料；

（四）成都高新区电子信息产业局作为项目申报组织部门对申报材料进行完整性初审，委托第三方会计师事务所进行审核审计，并组织专家对申报材料进行评审，必要时组织专家评审答辩或现场考察，并出具评审意见；

专家评审内容为：

- （1）是否符合支持方向（以申报通知为准）。
- （2）项目工艺技术先进性和适用性。
- （3）项目实施方案的合理性和可行性。
- （4）项目单位经营能力和工程建设管理能力。
- （5）项目的市场前景和经济效益。

(6) 申报人是否有弄虚作假行为。

(7) 相关票据证明材料的真实性和合规性。

(8) 提交的相关文件齐备、完整、有效。

(9) 规定的其他要求。

(五) 征求管委会相关部门意见；

(六) 由电子局组织项目审核专委会结合各环节评审意见及工作实际提出支持建议，拟定项目支持资金建议方案；

(七) 将拟支持名单在成都高新区公众信息网进行公示，公示期 5 个工作日。公示期间，发现申报单位有弄虚作假、知识产权纠纷以及违法违规等情况，经查实后取消扶持资格；

(八) 项目支持资金建议方案提请局党组会审议，通过后上报管委会审批；

(九) 资金到位后，办理资金拨付手续。

四、监督管理

(一) 资金绩效评价。成都高新区业务主管部门按照预算绩效管理的相关要求开展绩效评价工作。获得成都高新区财政扶持资金支持的企业或单位需上报政策扶持效果，配合做好项目验收及财政扶持资金绩效评价工作。

(二) 防止重复申报。成都高新区业务主管部门建立政策申报沟通机制，如发现重复申报同类扶持资金的单位，取消其当年享受成都高新区财政扶持资金的资格。

(三) 违法违规处罚。项目单位对申报事项及申报材料的真

实性、合规性、完整性和资金使用负直接责任。企业、机构、团队（个人）应做到诚信申请。对违反国家、省及成都市专项资金管理等有关规定，弄虚作假、骗取、套取财政资金，截留、挪用、转移或侵占奖补资金，擅自改变承诺实施事项等行为，视情况责令限期整改、停止拨付资金、限期收回已拨付的资金，同时按规定对项目单位和有关责任人进行处理，将项目单位及中介机构列入信用信息“黑名单”、取消项目单位3年内高新区集成电路专项资金申报资格。对构成犯罪的单位和个人，由司法机关依法追究其刑事责任。

（四）企业管理规范，有健全的财务管理制度和会计核算制度，近三年无严重失信行为，未被纳入失信被执行人名单。

（五）企业遵守安全生产、环境保护等方面的法律法规，近三年未发生造成人员死亡的安全生产及环境保护事故、重大违法行为。如出现环保、安全等责任事故，停止拨付资金，取消该项目资金申报资格。

（六）咨询、设计、审计等中介机构对其编制的资金申报报告、审计、评估等报告的客观性、公正性、独立性负责。

五、解释说明

（一）本政策属于《成都市加快集成电路产业高质量发展的专项政策》的成都高新区配套政策，与市级政策类似条款的支持比例和最高限额包含了市级政策的支持，经审核认定，超出市级支持的部分由成都高新区给予支持。

(二) 本实施细则具体条款由成都高新区电子信息产业局负责解释，并根据情况适时修改完善。

(三) 《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》（成高管发〔2022〕4号）中与成都高新区其他优惠政策实质相重叠的事项，按照就高不就低原则享受，且不重复享受。

(四) 享受“一企一策”政策的企业不再重复享受《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》（成高管发〔2022〕4号）中相关政策（相同、类似或“一企一策”明确不能享受等）条款。

(五) 本实施细则自2022年10月16日起执行，有效期与《成都高新技术产业开发区关于支持集成电路设计产业发展的若干政策（修订）》（成高管发〔2022〕4号）一致。

信息公开类别：主动公开

成都高新区电子信息产业局

2021年9月14日印发
